



カッティングエッジ

# CUTTING EDGE

71期事業のご報告

平成21年4月1日～平成22年3月31日



**DISCO**

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

# Kiru, Kezuru, Migaku

## 「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献しています。

### 1 高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという思いが込められているからです。

### 2 遠い科学を身近な快適につなぐとは

科学は日進月歩しています。しかしどれほど技術が進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。

ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いをこめています。

### 3 ディスコが追い求める成長とは

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダとの価値交換を通じ、長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。



Diamond Blade





## 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、 大幅な増益を達成いたしました

2009年度の世界経済は、リーマンショック後の最悪期を脱し、新興国を中心に景気が回復してまいりました。半導体業界においては政策的支援もあり、最終製品需要が一時的な落ち込みに留まった結果、いち早くメーカ各社の工場稼働率が改善し、下期にはアジア地域において設備投資が再開されました。このような中で、当社グループにおきましては、ダイシングソーを中心に精密加工装置の需要が大幅に増加し、消耗品である精密加工ツールも過去のピーク時に近い出荷となりました。さらに、レーザソーが高輝度LED切断用途で数多く採用され、前期比2.5倍の売上を計上しました。2001年より育成してきたレーザビジネスは新たな事業の柱となり、収益基盤の厚みを増すことになったと考えております。

また当期は、事業環境の変化が極めて大きい一年となりました。その変化に対応すべく期初の厳しい環境下では徹底したコスト削減に取り組みつつ、事業環境の好転に合わせ、積極的に販売活動と生産対応を行い、前期と比較して大幅な営業増益を達成いたしました。

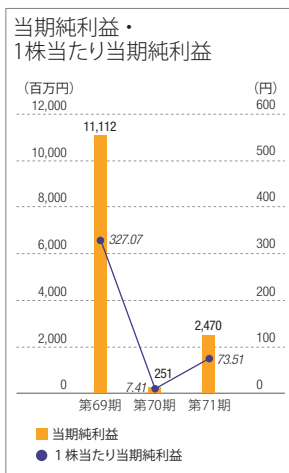
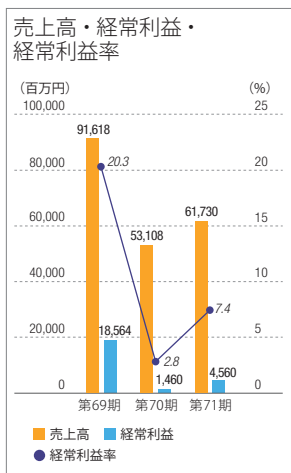
今後もKiru・Kezuru・Migaku技術の研究開発を継続し、さらに生産設備についても増強投資を継続いたします。株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2010年6月

代表取締役社長

**関家一馬**

## 財務ハイライト



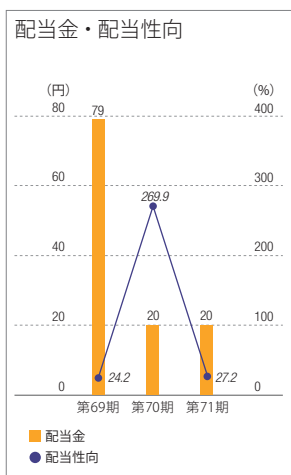
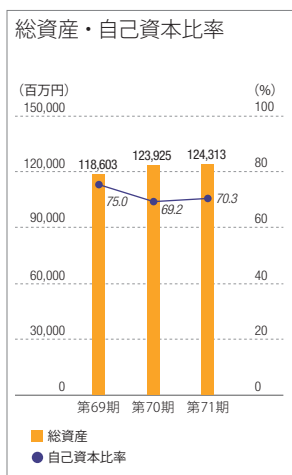
## 当期の概況

当社グループの主力事業である電子業界関連製品事業では、精密切断装置の売上が高輝度LED切断用レーザーの需要活発化、半導体IC向けブレードダイサやパッケージシングレーションダイサの需要回復などにより、前期と比較し大きく増加しました。精密研削装置においても、下期にアジア地域のサブコンを中心として設備投資が行われ、前期並みの売上となりました。また精密加工ツールは、為替の影響もありましたが早期に顧客の設備稼働率が上昇し、半導体需要も旺盛であったことから、売上高は堅調に推移しました。その一方で、一時休業や不況対策の実施、残業規制や研究開発テーマの絞り込みなども行い、コスト削減に努めてまいりました。

以上の結果、当期の業績は、売上高617億30百万円(前年度比16.2%増)、営業利益46億67百万円(前年度は76百万円の利益)、経常利益45億60百万円(前年度比212.2%増)、当期純利益は24億70百万円(前年度比883.6%増)となりました。

## 財政状態について

当期末の総資産は、1,243億13百万円(前期末比3億88百万円増)となりました。これは、借入金の期限前返済などにより現金および預金が減少した一方で、製品需要の回復による売上債権の増加や桑畑工場の新棟竣工などに伴い有形固定資産が増加したことによるものです。負債合計は、362億21百万円(前期末比13億74百万円減)となりました。これは、仕入れ債務の増加や設備投資を目的とした転換社債型新株予約権付社債により100億円の資金調達を実施した一方で、長期借入金の197億47百万円



の期限前返済を行ったことなどによるものです。この結果、自己資本比率は70.3% (前期末比1.1ポイント増)となりました。

## 配当について

当社は業績に連動した配当を実施することを基本方針とし、配当性向は連結当期純利益の20%としておりますが、利益水準に関わらず安定配当として最低限年間20円を維持いたします。

当期の配当につきましては、連結配当性向20%を適用した場合、1株当たり年間配当額が15円となることから、安定配当である1株当たり年間20円を適用いたします。それにより中間配当は10円としましたので、期末配当は10円とさせていただきます。次期の配当については、業績予想に基づき1株あたり年間50円を予定しております。

## 次期の連結業績予想

半導体市場は引き続き堅調に推移するものと見られ、メーカ各社における設備投資は増加すると見込まれます。特に台湾・韓国・中国のサブコン、ハンドラーメーカ、メモリーメーカなどの投資意欲が旺盛です。このような市場の状況を勘案した結果、平成23年3月期通期の連結業績は84億円の当期純利益を見込んでいます。

(金額の単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
平成23年3月期	86,500	12,100	13,200	8,400	249.95円



# 成長を加速する半導体市場と それに先行した ディスコの設備拡張

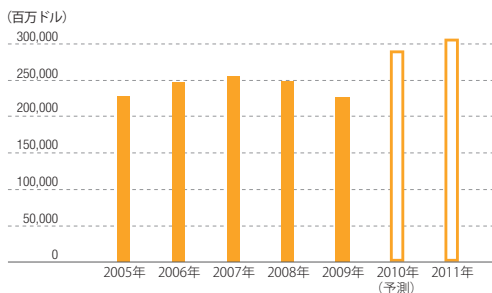
ディスコでは、将来の需要拡大に対応するために先行投資を行い、製品の安定供給に向けた準備を整えました。

## 半導体市場



世界の半導体市場は、2009年秋頃から半導体メモリの価格が回復し、足元では需給が逼迫するなど市場の好転が鮮明となっています。これは、各国政府の景気刺激策が奏功し、新興国における薄型テレビ・パソコンなどの販売の増加に加え、LED TV、ネットブック、スマートフォン、電子書籍端末などの新しい機器の台頭が原動力になっています。このように最終製品需要の高まりによって、DRAMやNAND型フラッシュメモリに品薄感が広がっていることから、半導体メーカー各社では増産に向けた投資を進めています。新興国におけるデジタル家電の堅調な販売などを背景に、2010年は半導体の更なる需要増加が見込まれています。

## 世界半導体出荷額

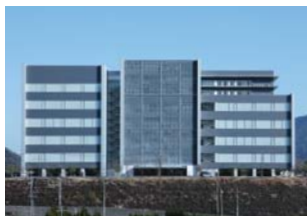


## 設備の拡張

ディスコでは、2010年1月に精密加工装置および精密加工ツールを製造する桑畑工場に新棟を竣工しました(地上8階建て、延べ床面積6万3000平方メートル(約19,000坪)、総投資額約110億円)。2010年5月には生産設備の移設を完了しており、生産キャパシティは従来の2倍に拡大されました。製造現場もこれまで長谷工場で行っていたスピンドルやチャックテーブルなどの部品製造を移管・集約させることで生産効率向上を図ります。このように半導体メーカ各社の設備投資増大に備え、工場機能を拡大して生産体制を整えています。

この桑畑工場新棟は2008年9月に着工しましたが、その後発生した世界同時不況の影響から半導体メーカ各社の設備投資が極めて低迷し、半導体製造装置メーカも非常に苦しい状況に置かれていました。

しかし、ディスコでは早い段階から消耗品である精密加工ツールの需要が回復、精密切断装置もLED向けに需要が活発化したことから、2009年度第2四半期(2009年7～9月)には売上高が138億円となり、営業損益が黒字に転換し、同第3四半期(同年10～12月)では、売上高が対前年同期比62%増、対前四半期比30.4%増の180億円となりました。



桑畑工場新棟



工場内部

このような業績回復を受けて2009年度には、呉工場の新棟建設を決定し他社に先駆けていち早く設備投資を再開しました。

今回の桑畑工場新棟の竣工は、将来のさらなる需要拡大への対応のほか、BCM対応力(地震などの災害時にも製品を安定供給できる環境)の向上を実現します。例えば、各フロアで床素材に異なる色を採用した上、柱にアルファベットと数字を組み合わせた番地を表示して、緊急時であっても自分の居場所がわかりやすく、避難もしやすい工夫をしています。

※BCM：Business Continuity Management/事業継続管理



## 会社情報および株式の状況 (2010年3月31日現在)

### 会社概要

本社所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号		
創業年月日	1937年5月5日		
設立年月日	1940年3月2日		
資本金	14,517百万円		
従業員数	単体1,661名	連結2,465名	
主な事業内容	精密加工装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 製造および販売</li> <li>→ メンテナンスサービス</li> <li>→ オペレーションやメンテナンスの研修サービス</li> <li>→ 解体リサイクル事業</li> <li>→ リースおよび中古品売買</li> </ul>	
	精密加工ツール	→ 製造および販売	
	精密部品の有償加工サービス		

### 役員 (2010年6月25日現在)

代表取締役会長	溝呂木 斉	常勤監査役	巳亦 力
代表取締役社長	関家 一馬		高柳 忠雄
常務取締役	関家 圭三	監査役	浅海 芳久
取締役	関家 英之		黒沼 忠彦
	梶山 啓一	執行役員	荒井 一尚
	田村 隆夫		吉永 晃

### 株式概要

上場市場	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード6146)		
発行済株式総数	34,004,418株		
株主数	15,168名		
大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	: 4,287千株 / 12.61%	
	日本マスタートラスト信託銀行(株)	: 2,320千株 / 6.82%	
	(株)ダイイチ企業	: 1,998千株 / 5.88%	
	(株)ダイイチホールディングス	: 1,998千株 / 5.88%	
	(株)OctagonLab	: 1,704千株 / 5.01%	
	関家 臣二	: 1,360千株 / 4.00%	
	(株)オレンジコーラル	: 1,146千株 / 3.37%	
	日本生命保険(相)	: 817千株 / 2.40%	
	関家 圭三	: 794千株 / 2.34%	
	資産管理サービス信託銀行株式会社	: 736千株 / 2.17%	

### 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金	
受領株主確定日	3月31日
中間配当金	
受領株主確定日	9月30日
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711 (通話料無料) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
公告の方法	電子公告により行います ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは日本経済新聞に掲載して行います

## 株式会社 ディスコ

143-8580  
東京都大田区大森北 2-13-11  
<http://www.disco.co.jp/>

